上海硅产业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

**股票名称：沪硅产业 股票代码：688126**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | 🗹特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 🗹电话会议 |
| **参与单位/个人** | 国信、中金、国泰海通、长江、华泰等机构和个人投资者通过电话和网络参加会议。 |
| **时间** | 2025年9月1日 |
| **地点** | 线上交流 |
| **公司接待人员** | 邱慈云、李炜、黄燕、方娜 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、半导体行业和沪硅产业经营情况介绍  今年上半年，全球半导体市场、包括半导体硅片市场整体都有所改善，但复苏速度慢于预期。在这样的大环境下，沪硅产业面临着诸多挑战。从业绩数据来看，我们上半年实现营业收入16.97亿元，同比增长8.16%。其中第二季度单季营收8.96亿元，环比第一季度增长 11.75%。然而，我们归属于上市公司股东的净利润仍然为负，这主要是由于硅片市场的复苏滞后于终端市场、芯片制造等产业链的下游环节，硅片产品价格在全球范围内仍面临较大压力，再加上我们持续扩产带来的折旧摊销费用、持续较高水平的研发投入及其他固定成本增加的影响，导致短期内仍然处于亏损状态。  在业务方面，我们的300mm硅片业务取得了显著进展。公司的产能利用率处于较高水平，出货量同比有所增加。上半年，我们上海、太原两地300mm硅片合计产能已达到75万片/月，规模位居国内第一梯队。  我们在技术研发和新产品成果上亮点颇多。上半年，我们开发了50余款300mm硅片新产品。截至2025年6月末，公司300mm硅片业务的累计客户数量超过100家，产品广泛用于逻辑芯片、存储、CIS等应用。我们的 300mm硅片产品凭借高纯度、低缺陷、良好的表面质量和性能参数，以及稳定的供应，受到了相关客户的高度认可。  在300mm SOI业务上，作为国内唯一具备300mm硅片衬底和300mm SOI产品技术全自主知识产权和技术能力的企业，我们在国内的领先性更是凸显。公司300mm SOI业务在过去半年里取得了阶段性突破，已开始向多客户批量送样。特别是面向高压高可靠性高算力应用的300mm SOI 硅片已正式开始流片，目前已完成客户送样并通过客户内部的特殊工艺验证。目前，我们的300mm SOI产品能够满足各类应用领域对衬底材料的严格要求，并已与多家行业内领先的设计及制造企业建立了合作关系，具备为其提供高质量的300mm SOI硅片的能力。  然而， 200mm及以下的硅片市场还未完全复苏，公司200mm及以下尺寸硅片业务表现仍较为疲软。不过，我们的子公司在各自领域都在积极探索。芬兰Okmetic持续推进其产品在MEMS、传感器、射频滤波器和功率器件领域的应用；新傲科技在200mm SOI和200mm及以下外延业务方面持续推动转型升级，着眼产品高性能应用，以期在IGBT/FRD等产品应用市场争取获得更广泛的渗透。  从行业发展趋势来看，虽然当前面临挑战，但我们对未来充满信心。随着终端市场需求的持续增长，下游客户库存水平逐步正常化，半导体硅片出货量及价格的持续回暖值得期待。特别是各类新兴市场的崛起，将为半导体硅片行业带来新的增长动力。展望未来，我们将继续坚持技术研发、新产品开发和市场开拓。在技术研发上，不断突破创新，尤其是在300mm硅片业务和300mm SOI 业务上，持续提升产品的技术含量和附加值，以满足新兴市场对高性能硅片的严苛需求；在新产品开发上，紧密围绕市场需求，扩充产品种类；在市场开拓上，进一步扩大国内外市场份额。  2、投资者交流  问1：当前半导体硅片价量的情况。  答：从量的方面，300mm硅片需求持续增长，尤其在存储领增速明显；200mm硅片已触底，但复苏较为缓慢。从价格方面，仍然承压，主要来自新进竞争者、客户降本要求及市场竞争加剧。  问2：2025年、2026年的折旧预期  答：2024年折旧约9亿元，2025、2026年仍处于资本开支高峰期，后续随设备完全折旧后，增速会逐步下降。  问3：当前200mm和300mm硅片的产能利用率  答：300mm产能利用率较高，200mm回升仍然略显乏力，个别品种开工率较高。  问4：硅片产品的国产化率  答：300mm硅片在存储领域国产化率高于逻辑芯片，200mm硅片除特殊产品外已基本实现国产化。  问5：公司300mm产品产能规划及海外市场规划  答：目前产能已达到75万片/月，已公布的产能规划将达到120万片/月。海外市场拓展方面，公司已与较多海外客户建立合作，未来将借助海外子公司渠道进一步提升国际销售占比。  问6：300mm硅片未来价格提升空间及下游领域复苏情况  答：随着正片占比提升、LTA订单结束及整体市场需求增长，价格有望企稳回升。300mm硅片需求整体向好，下游市场中，存储、逻辑和功率器件等领域预计率先复苏，消费电子和手机市场需等待AI应用驱动增长。  问7：掺砷产品进展  答：掺砷产品在太原基地研发生产，目前已向客户送样，正处于认证阶段，预计未来几个月将取得进展。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2025年9月1日 |